

目次(1/4)

	<頁>		<頁>
第1章 半導体パッケージの種類と使用例	7	第3章 半導体の組立とは何か	37
1 真空管	8	1 一般の組立イメージ	38
2 真空管ラジオ	9	2 接合と接着の分類	39
3 トランジスタ	10	3 半導体の接着組立の種類	40
4 トランジスタテレビ	11	4 接着理論	43
5 DIP	12	5 剥離(破壊)理論	48
6 端子挿入型	13		
7 家庭用TVゲーム機	14	第4章 QFPの組立工程	55
8 冷蔵庫・エアコン	15	1 QFP組立概要	56
9 QFP	16	2 BGA組立概要	57
10 SOP	17	バックグライディング工程	58
11 Jリード表面実装型	18	3 バックグライディング	59
12 第二世代TVゲーム機	19	4 ストレスによる微小クラック	60
13 BGA	20	5 ストレス除去法	61
14 BGA、QFN	21	ダイシング工程	62
15 テレビ、パソコン	22	6 ダイシングとは	63
16 放熱板付きBGA	23	7 キャリアリング構造	64
17 第三世代TVゲーム機	24	8 粘着シート貼付け	65
18 FCBGA	25	9 粘着シート貼付け工程	66
19 第四世代TVゲーム機	26	10 ダイサ構造	67
20 高性能コンピュータ	27	11 ダイシングブレード	68
21 QFPのMCP	28	12 ステップカット方式	69
22 車搭載機器制御	29	13 ダイシングのカット方式	70
23 BGAのMCP	30	14 ダイシング順	71
24 携帯電話、デジカメ	31	15 ダイシングの不良項目	72
25 パッケージ外形の呼び方	32	16 チップ割れ	73
		17 UV照射の方法	74
第2章 半導体パッケージの役割	33	ダイボンディング工程	75
1 半導体パッケージの役割	34	19 ダイボンディングの種類	76
2 QFPの役割	35	20 樹脂ペーストダイボンダ構造	78
3 パッケージに必要な性能	36		

目次(2/4)

	＜頁＞		＜頁＞
21 各種金属特性	79	51 封止樹脂の製造方法	114
22 樹脂ペースト接着法の構造	80	52 樹脂の管理と廃棄処理	115
23 ダイ接着剤の役割	81	53 封止工程(トランスファモールド方式)	116
24 リードフレーム	82	54 封止金型断面構造と不具合例	118
25 リードフレーム製造方法(エッチング)	83	55 ポップコーン現象	119
26 リードフレーム製造方法(プレス)	84	タイバー切断工程	120
27 ダイピックアップ方法	85	57 タイバーの役割	121
28 ダイ良否認識方法	86	58 タイバー切断・リード曲げ型構造	122
29 ディスペンサの仕組み	87	59 タイバー切断工程	123
30 ディスペンス方式の種類	88	リード外装めっき工程	124
31 樹脂ペーストの吐出	89	60 電気めっきの理論	125
32 樹脂ペーストのダイボンディング	90	61 電解脱脂	126
33 樹脂ペーストのキュア	91	62 バリ取り(高圧水洗浄)	127
34 リードフレーム供給方式	92	63 酸洗浄	128
35 ダイボンディング不良の種類	93	64 エッチング	129
36 ダイシェアテスト	94	65 電気はんだめっき	130
ワイヤボンディング工程(接続工程)	95	66 中和	131
38 ワイヤボンディング用キャピラリ	96	67 水洗浄	132
39 ワイヤボンディングの概要	97	68 乾燥	133
40 ワイヤボンディングの接着構造	98	69 めっき評価方法	134
41 ワイヤボンダ構造	99	マーキング工程	135
42 ワイヤボンディングの方法	100	70 インクマーキング	136
43 リバースボンディングの方法	104	71 レーザマーキング	137
44 ワイヤプルテスト	107	72 レーザ光線の特徴	138
45 ボールシェアテスト	108	端子形成・個片化工程(シンギュレーション)	139
46 ピールテスト	109	73 リード先端切断工程	140
封止工程	110	74 リード成形(しごき曲げ)	141
48 トランスファモールド樹脂封止装置構造	111	75 リード成形(ローラ曲げ)	142
49 封止金型方式の種類	112	76 リード成形(カム曲げ)	143
50 封止樹脂材料の構成	113	77 コプラナリティ(リード平坦度)	144
		78 実装不良(はんだ濡れ性不良)	145
		装置・使用材料・器工具(治工具)まとめ	146

目次(3/4)

	<頁>		<頁>
第5章 BGAの組立工程	147	第10章 品質管理	175
1 BGAの基板	148	QC七つ道具	
2 BGAの基板製造方法	149	1 特性要因図	176
ワイヤBGA		2 チェックシート	177
3 ワイヤBGAの組立工程	150	3 ヒストグラム	178
4 はんだボールのセルフアライメント性	152	4 散布図	179
5 基板ダイシング切断	153	5 パレート図	180
6 一括封止BGA	154	6 管理図	181
FCBGA		7 層別	182
7 FCBGAの組立工程(バンパ付け)	155	静電気対策	
8 FCBGAのチップ個片化	156	8 静電気対策	183
9 FCBGAの組立工程	157	信頼性関係	
第6章 セラミックパッケージの組立工程	159	9 バスタブカーブ	186
1 セラミックパッケージのウェッジ(ツール)	160	10 パッケージ信頼性試験	187
2 セラミックパッケージの組立工程	161	11 MTBF・MTTR	188
3 セラミックパッケージの封止工程	163	12 SAT(超音波探傷器)	189
4 セラミックパッケージの気密試験	164	13 軟X線	191
第7章 TCPの組立工程	165	14 PL法、EM	192
1 TCPの組立工程	166	清浄度	
2 TCPとCOFの断面構造	167	15 クリーンルーム	193
第8章 WSPの組立工程	168	第11章 環境管理	194
1 WSPの再配線工程	169	1 環境問題の高まり	195
2 WSPの個片化	170	2 公害	196
第9章 テスト工程	171	3 化学物質の危険性	197
1 テスト工程フロー	172	4 資源の枯渇(リサイクルの必要性)	198
2 テストで判る組立不良	173	5 京都議定書	199
3 電氣的機能テスト	174	6 モントリオール議定書	202
		7 グリーン製品	204
		8 RoHS指令	205
		9 PRTR	206

目次(4/4)

10 化学物質の主な法体系	<頁> 207	2級 学科試験 過去問題解説	<頁> 229	
11 MSDS	208		平成17年度	A群(真偽法) 230
12 3R(リデュース、リユース、リサイクル)	209			B群(多肢択一法) 235
13 ゼロエミッション	210		平成16年度	A群(真偽法) 248
14 家電リサイクル	211			B群(多肢択一法) 252
15 ISO14000	212		平成15年度	A群(真偽法) 263
第12章 安全衛生	214			B群(多肢択一法) 267
1 労働災害の現状	215		平成14年度	A群(真偽法) 277
2 安全の三原則	216			B群(多肢択一法) 281
3 ハインリッヒの法則	217		参考文献	292
4 労働災害低減活動	218			
5 KYT・安全配慮義務	219			
6 有機溶剤中毒予防	220			
7 採光および照明の衛生基準	221			
第13章 生産管理	222			
1 製造原価の構成	223			
2 損益分岐図表	224			
3 歩留り計算法	225			
第14章 設備要素	226			
1 エアシリンダ構造	227			
2 図面の表記法	228			